

V9

No-Clean-Lotpaste

KEINE VOIDS SIND DIE BESTEN VOIDS



NEU

HAUPTMERKMALE

- Geringe bis keine Lunkerbildung; <1% bei BGA- und <5% bei BTC-Komponenten
- REACH- und RoHS-konform
- Konsistentes Druckvolumen ab Flächenverhältnis <0,66
- Klare, pin-testbare und hochzuverlässige Rückstände
- Stabile Druckleistung 12+ Stunden
- Erhältlich in SAC305 T4

SIE WOLLEN VOIDS ELIMINIEREN?

V9 kann BTC-Bauteile ohne Vakuum-Reflow mit sehr geringen/keinen Voids produzieren.

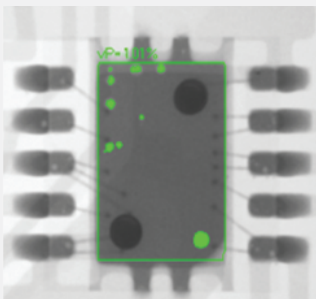
V9 Low-Voiding No-Clean-Lotpaste wurde speziell entwickelt, um die Lunkerbildung bei allen Bauteiltypen einschließlich QFN, LGA, BGA, D-PAK und anderen lunkerempfindlichen Bauteilen ohne Vakuum-Reflow zu minimieren. V9 reduziert die Lunkerbildung bei BGAs auf 1 % und bei BTCs auf <5 % und bietet gleichzeitig eine stabile Leistung bei ultrafeinem Pitchdruck mit Flächenverhältnissen <0,66 über 12 Stunden. Seine Rückstände sind klar, leicht auf Pins prüfbar und haben hohe SIR-Eigenschaften, ideal für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. V9, eine No-Clean-Lotpaste mit geringer Lunkerbildung, ist in SAC305 T4 erhältlich und kann mit den meisten No-Clean-Lotpasten von AIM ausgetauscht werden. ***Mit der neuen V9 Low-Voiding-Lotpaste von AIM lassen sich Lunker beseitigen, ohne die Druckleistung zu beeinträchtigen.***

👉 **V9 Keine Voids sind die besten Voids.**

Wenden Sie sich an Ihren AIM-Vertreter und fordern Sie noch heute Ihr kostenloses Muster an.

V9 Low-Voiding-Paste

VOIDING: $\leq 1\%$



Typische Mitbewerberpaste

VOIDING: $\geq 9\%^{+UP}$

